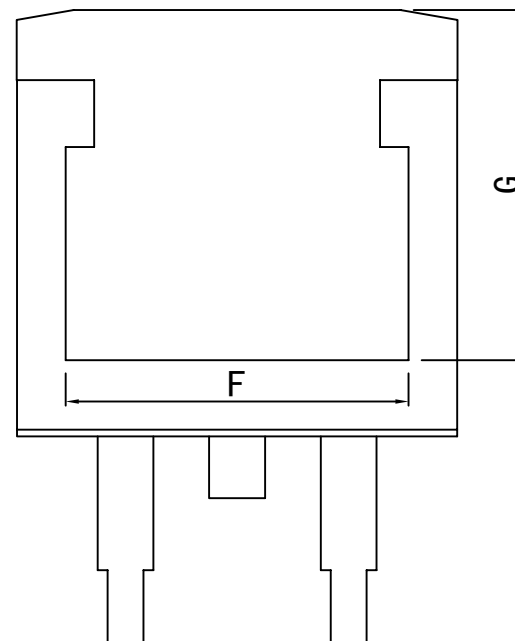
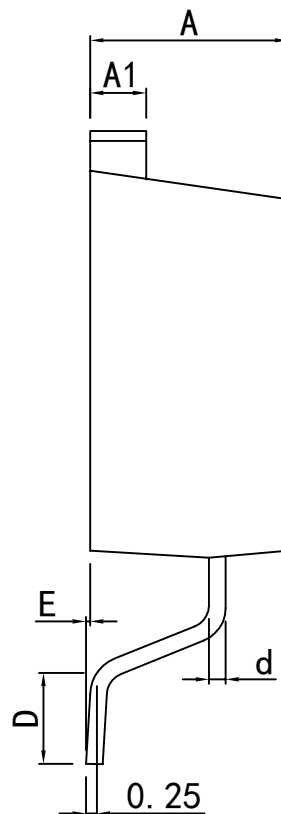
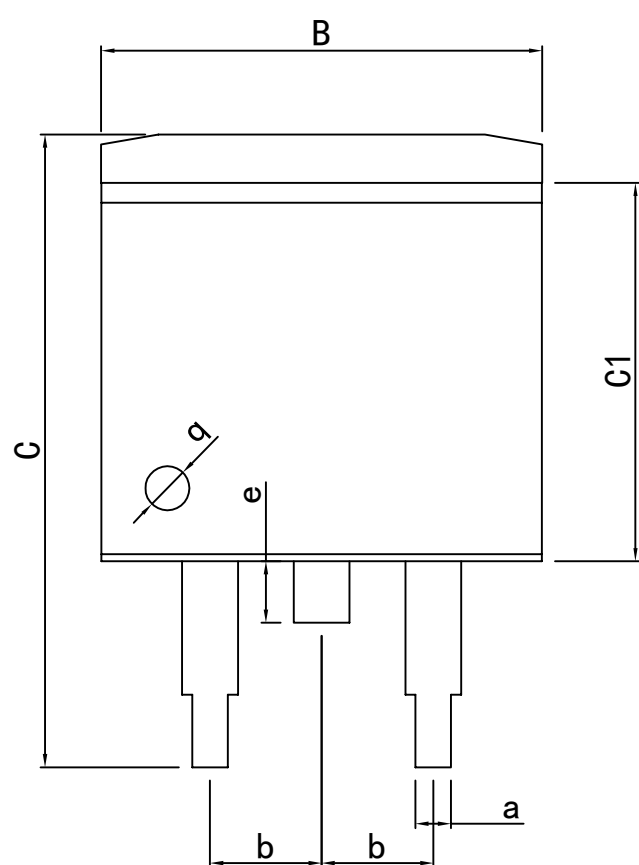




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

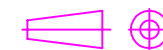
T0263-2

文件名称:
HG-T0263-2

文件编号:
HGWXT-230026

版本	VI.0
比例	1:1
单位	mm
日期	2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	E	F	G	a	e	b
MIN	4.45	1.22	10.00	13.7	8.38	1.89	0.00	8.30	7.70	0.71	1.10	2.54
MAX	4.62	1.32	10.40	14.6	8.89	2.19	0.305	8.55	8.10	0.89	1.70	BSC